

第89回講演会レーザー加工学会 大阪大学 銀杏会館 (予告プログラム)

1日目 2018年5月23日(水)

ホール			
10:00 開会の辞			
10:05	ポスターショートプレゼンテーション(各2分間、ホール) + ポスタープレゼンテーション	塚本雅裕(大阪大学)	
	ポスター講演		ポスター展示 & カタログ展示
1	品質工学(タグチメソッド)を用いたフェムト秒レーザーによる加工条件最適化	舟山博人 (光産業創成大学院大学)	レーザーライン株式会社 ジャパンセンサー株式会社
2	フェムト秒レーザーピーニング処理を施した2024アルミニウム合金の材料特性	春日 仁希 (大阪大学)	ピーアイ・ジャパン株式会社 愛知産業株式会社
3	ガラスのフェムト秒レーザーあけ加工におけるダメージ形成メカニズム	伊藤 佑介 (東京大学)	株式会社ワイ・イー・データ IPGフォトニクスジャパン株式会社
4	2.8 μm中赤外ファイバレーザー開発のための フェムト秒レーザー内部加工によるグレーティング構造の書込み	合谷 賢治 (大阪大学)	光産業創成大学院大学 株式会社 ナックイメージテクノロジー
5	Fabrication of Silver nanoparticles by Laser Ablation in Water	Htet Sui Wai (宮崎大学)	株式会社プロフィテット 新東工業株式会社
6	高強度・高フルエンスパルスEUV光による材料プロセス	田中 のぞみ (大阪大学)	Gentec EO Lapan 合同会社 トルンプ株式会社
7	真空紫外光照射によるアクリル樹脂の光脱離現象	松本 和也 (宮崎大学)	株式会社ナ・デックス
8	Co-Cr-W系超硬合金三次元積層造形とその微細組織および機械的特性	三宅 将史 (大阪大学)	
9	SLMを用いたTi合金の造形におけるスパッタの影響	西 貴哉 (大阪大学)	
10	青色半導体レーザーを用いた純銅のアドティブマニファクチャリング技術の開発	柴田知希 (大阪大学)	
昼食休憩(12:00~13:00)			
ホール			
プレナリーセッション 佐野智一 (大阪大学)			
13:00	【基調講演1】 レーザー加工のモニタリングと知的生産システム	小林 洋平 (東京大学)	
13:50	【基調講演2】 革新的イノベーション創造プログラム(SIP)革新的設計生産技術「高付加価値設計・製造を実現するレーザーコーティング技術の研究開発」およびNEDOプロジェクト「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」における高輝度青色半導体レーザー開発	塚本 雅裕 (大阪大学)	
総会 (14:40~15:10)			
Coffee break (15:10~15:20)			
ホール		大会議室	
23A1	レーザー加工の優位性ー競合加工技術との比較	木谷靖(JFEスチール株)	23B1 短パルスレーザーを駆使した細胞制御
15:20	【特別講演】レーザー・電子ビーム・アークによる3D金属積層造形技術の比較	木寺 正晃 (愛知産業株)	15:20 【特別講演】短パルスレーザーを応用した眼科医療機器開発
16:00	溶断工場に用いられる各種切断機の性能と特長	上木原 洋丘 (日酸TANAKA株)	16:00 短パルスレーザーを駆使した細胞組織化・疾病メカニズムの解明
16:30	レーザー溶接と電子ビーム溶接の比較	西原 啓三 (東成エレクトロビーム株)	16:30 超短パルスレーザーを用いた機能性ポリマーの3次元バイオチップデバイス作製
17:00	レーザー焼入れと高周波焼入れの比較	後藤 光宏 (富士高周波工業)	17:00 フェムト秒レーザー細胞制御による生体組織の治癒メカニズムの解明
17:30	終了		17:30 終了
懇親会 (17:45~19:30)		ポスター講演優秀賞発表	

第89回講演会レーザー加工学会 大阪大学 銀杏会館 (予告プログラム)

2日目 2018年5月24日(木)

ホール		大会議室	
24A1	高効率・コンパクトレーザーおよびモニタリング技術	門屋輝慶(LTF)	24B1 ナノ・マイクロ加工、産業応用
9:30	【特別講演】トルンプの最新レーザー溶接システム	中村 強 (トルンプ㈱)	9:30 超短パルスレーザーによる金属加工プロセスの現象可視化
10:10	ファイバレーザーによる異種金属の接合	田村 悟 (住友重機械工業㈱)	10:00 Beamshaping of High Power Single Mode UV Lasers
10:40	最新ファイバレーザー及び周辺機器とその応用	水谷 重人 (コヒレント・ジャパン㈱)	10:30 レーザによる繊維への微細マーキングと眼鏡レンズ染色
11:10	RLSK with Seam Tracking Easy, Flexible and Safe Welding Tool	Matthias Kuehnel (II-VI)	11:00 Ni基超々合金のレーザー肉盛
昼食休憩 (11:40~12:40)		昼食休憩 (11:30~12:30)	
ホール		大会議室	
24A2	レーザー加工応用・適用事例	山崎洋輔(日立造船㈱)	24B2 ビーニング
12:40	100 kWファイバレーザーによるビード整形工法	住森 大地 (㈱ナ・テックスプロダクツ)	12:30 【特別講演】レーザービーニングのこれまでとこれから
13:10	超伝導トカマク装置JT-60SAにおける真空容器内機器保守に向けたレーザー溶接ツールの開発	林 孝夫 (量子科学技術研究開発機構)	13:10 携帯型装置の開発に向けたレーザービーニングの低出力化の検討
13:40	レーザーラッドバルブシート開発	大石 悠佑 (トヨタ自動車㈱)	13:40 ショットビーニングとレーザービーニングの効果の違いとそのアプリケーション
14:10	レーザー積層造形法により作製した析出型Cu-Cr合金の特性	内田 壮平 (大阪産業技術研究所)	14:10 新しいレーザービーニング技術 ~犠牲層を用いない大気中で施工可能なドライレーザービーニング~
14:40	フォトニック結晶構造ファイバによるハイパワー伝送技術	藤谷 泰之 (三菱重工業㈱)	
Coffee break (15:10~15:30)		Coffee break (14:40~15:00)	
ホール		大会議室	
24A3	レーザー加工現象解析・シミュレーション	尾崎仁志(三重大学)	24B3 パターニング技術
15:30	レーザー切断加工におけるダイナミック現象—熱源スポットの形成と切断への関与—	新井 武二 (中央大学)	15:00 【特別講演】レーザー照射とグリオキシル酸銅錯体を用いた大気中での銅パターニング
16:00	【特別講演】計算科学シミュレーションコード SPLICE によるレーザー溶融・凝固プロセスの評価	村松 壽晴 (日本原子力研究開発機構)	15:40 【特別講演】レーザー転写技術を用いた強誘電体薄膜の圧電基板への集積化
16:40	SLM過程におけるレーザー照射部周りの温度分布と溶融池形状の予測	池庄司 敏孝 (近畿大学)	16:20 レーザ技術によるストレッチャブル配線パターニング
			16:50 レーザー彫刻印刷版によるプリンテッドエレクトロニクスへの展開
17:10	終了		17:20 終了